

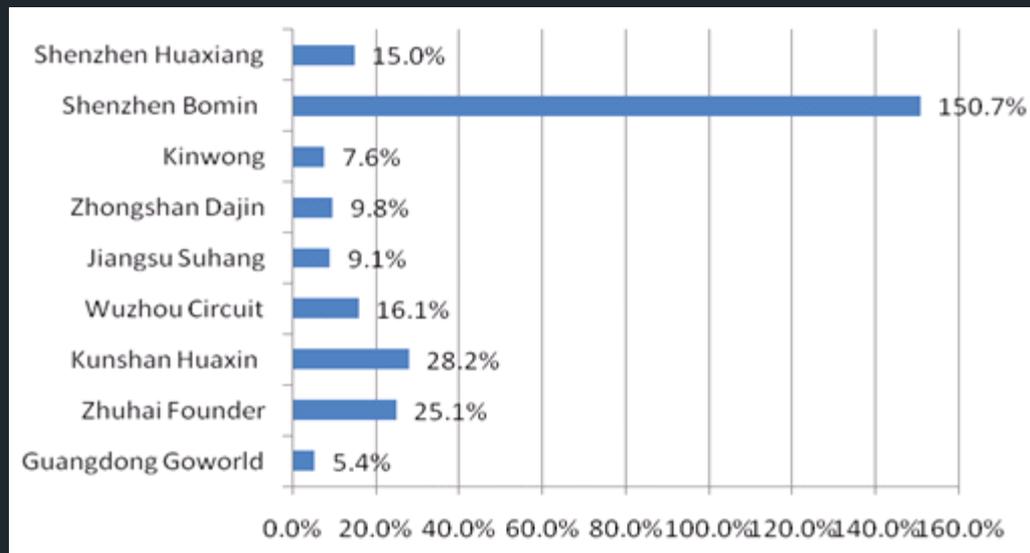
2010年全球及中国PCB行业研究报告



- 2009年，全球PCB产业产值约406亿美元，同比2008年下降15.83%，PCB出货量及平均价格的持续下降都是主要的影响因素。从主要细分行业来看，2009年全球载板、硬板、软板产业均出现不同程度下滑，产值规模对比2008年分别下降50%、20%和3.8%。其中，全球载板、硬板产业产值的下滑主要受台式机以及中高阶NB销售量大幅下滑的影响。相较而言，受惠于LED背光、Smart Phone软板设计片数增加及触控面板热潮，2009年全球软板产业下滑幅度较小。
- 2000年到2009年，应用于电脑的PCB产值下降3%，应用于通讯的下降13.5%，应用于消费电子的增长15.8%，封装载板增长68%，应用于工业/医疗的下降20.5%，应用于军事的下降20.1%，应用于汽车的下降26.8%。
- 2000年到2009年，单/双面板产值下降37.3%，多层板产值下降25.2%，HDI（高密度互联）板产值增加163.1%，封装载板产值增加68.1%，软板产值增加约90.0%。
- 2009年，从PCB产业全球分布格局来看，中国大陆、日本和中国台湾仍是三大主要产地，韩国PCB产业规模在持续扩大，欧美PCB产业则整体处于衰退之中。相较于日韩在IC载板、柔性板等高端产品、台湾在手机板产品方面的优势，目前以单面板、多面板为主的中国PCB产业技术含量明显偏低。

- 2009年，中国PCB产业实现产值163.5亿美元，首次出现小幅下滑，产值规模同比2008年下降3.6%，但中国PCB产值占世界市场份额比例继续上升。2009年，中国PCB行业销售收入100强中，本土企业表现出了良好的上升趋势，其中博敏电子销售收入同比2008年上涨150.7%。

图：2009年中国PCB产业主要本土企业销售收入增长幅度



来源：中国印制电路行业协会；整理：水清木华研究中心

报告目录

- 第一章 PCB的应用领域
 - 1.1 手机PCB产业
 - 1.2 内存模块用PCB
 - 1.3 光电板用PCB
 - 1.4 笔记本电脑与DV用PCB
 - 1.5 汽车电子PCB

- 第二章 PCB产业
 - 2.1 PCB产业链简介
 - 2.2 2009年PCB产业回顾与2010年展望
 - 2.3 PCB产业技术格局
 - 2.4 PCB产业地域格局
 - 2.5 台湾PCB产业
 - 2.6 大陆PCB产业
 - 2.7 FPC市场规模
 - 2.8 FPC产业链
 - 2.9 FPC产业地域分布
 - 2.10 FPC客户供应关系
 - 2.11 FPC产业排名
 - 2.12 PCB行业内部排名

- 第三章 典型PCB厂家研究
 - 3.1 Samsung Electro
 - 3.2 AT&S
 - 3.3 Guangdong Goworld Co., Ltd
 - 3.3.1 企业简介及运营情况
 - 3.3.2 公司业务发展优势
 - 3.3.3 2010年发展趋势分析
 - 3.4 Aspocomp
 - 3.5 Founder PCB
 - 3.6 Meiko Electronics Co., Ltd
 - 3.7 Meadville Group
 - 3.8 Unimicron
 - 3.9 COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD
 - 3.10 Unitech
 - 3.11 WUS Printed Co., Ltd
 - 3.12 GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD
 - 3.13 Chin Poon Industrial Co., Ltd
 - 3.14 Tripod Technology Corporation
 - 3.15 PLOTECH TECHNOLOGY
 - 3.16 HannStar Board Co., Ltd
 - 3.17 Tianjin Printronics Circuit Corp
 - 3.18 Kingboard Chemical Holdings Ltd
 - 3.19 DYnamic Electronics Cp., Ltd
 - 3.20 TAIWAN PCB TECHVEST CO.,LTD
 - 3.21 Viasystems Group Inc
 - 3.22 Daisho Microline Limited
 - 3.23 IBIDEN CO.,LTD

图表目录

- 表：手机板技术趋势
- 图：2009年苹果手机PCB供应厂家及占比
- 图：2009年RIM手机PCB供应厂家及占比
- 图：2006、2009年诺基亚手机PCB板主要供应商及占比
- 图：2006、2009年三星手机PCB板供应商及占比
- 图：2006、2009年LG手机PCB板供应商及占比
- 表：主要手机厂家PCB供应商
- 图：2009年全球手机PCB厂家市场占有率（按收入）
- 图：2006、2009年内存领域主要PCB板供应商市场占有率
- 图：2006、2009年台湾光电板主要厂家市场占有率
- 表：笔记本电脑用PCB技术路线图
- 图：2006、2009年全球笔记本电脑PCB板主要厂家市场占有率
- 图：覆铜板行业与PCB行业成本结构
- 图：1997-2009年全球PCB产值
- 图：1999-2009年全球PCB出货量与平均价格
- 图：1997-2011年全球PCB产值
- 图：2000、2009年全球PCB下游应用比例
- 图：2000、2009年全球PCB产品结构
- 图：2006-2011年全球PCB产值地域分布
- 图：2007-2012年台湾PCB产业产值
- 图：2008-2010年台湾PCB产值地域分布
- 图：2009年台湾PCB产值技术分布
- 图：2007-2012年中国大陆PCB市场规模
- 图：2008-2010年中国大陆PCB产值地域分布

- 图：2008-2010年中国大陆PCB各细分市场占比
- 图：2008-2010年中国大陆PCB下游应用比例
- 图：2007-2013年FPC市场规模
- 图：2007-2013年FPC市场下游分布
- 图：台湾软板产业链
- 图：2009年FPC产业地域分布（按企业总部所属地域计算）
- 图：2009年FPC产业地域分布（按产出地计算）
- 表：日本FPC厂家排名
- 表：韩国FPC厂家排名
- 表：台湾FPC厂家排名
- 表：大陆及香港FPC厂家排名
- 表：2004-2008年全球前20大PCB厂家收入统计
- 表：2009年全球18大PCB厂家排名
- 表：2009年台湾20大PCB厂家排名
- 图：2009年-2010Q1三星电机销售额与毛利润统计（单位：bn KRW）
- 图：2010Q1三星电机各部门收入结构比例统计（单位：bn KRW）
- 图：2010Q1三星电机ACI部门收入结构（单位：bn KRW）
- 图：2010Q1三星电机LCR部门收入结构（单位：bn KRW）
- 图：2010Q1三星电机OMS部门收入结构（单位：bn KRW）
- 图：2010Q1三星电机CDS部门收入结构（单位：bn KRW）
- 图：2009年第四季度AT&S财务数据
- 图：2006-2009财年AT&S各部门收入及占比
- 图：2008-2009财年AT&S各地区收入占比
- 图：2008-2009财年AT&S奥地利经营业绩
- 图：2008-2009财年AT&S亚太地区经营业绩
- 图：2007-2009年超声电子主营业务收入统计（单位：百万RMB）

- 图：2007-2009年各季度超声电子净利润统计（单位：百万RMB）
- 表：2009年超声电子收入的产品构成和区域构成
- 图：2008Q4-2009Q4 AspoComp营业收入及毛利润统计（单位：百万欧元）
- 图：方正PCB产业组织结构
- 图：founderPCB产业布局
- 表：founderPCB HDI技术指标
- 表：founderPCB Backplane & Line card技术指标
- 表：founderPCB Backplane & Line card技术指标
- 图：founderPCB Gold Finger PCBs技术指标
- 表：founderPCB Substrate技术指标
- 表：Meiko发展历程
- 表：Meiko全球业务覆盖范围
- 图：2008Q4-2009Q4名幸电子收入与毛利润统计（单位：百万日元）
- 图：2009Q3名幸电子各地区营收统计（单位：百万日元）
- 图：2009Q2-Q3名幸电子产品应用领域及收入占比
- 图：2009Q2-Q3名幸电子PCB按层数的收入结构
- 表：Meadville Group Technology Roadmap for Conventional PCB
- 表：Meadville Group Technology Roadmap for HDI PCB
- 表：Meadville Group Technology Roadmap for IC Substrate
- 表：2009H1美维科技集团财务数据统计
- 图：2004-2008 Meadville Group Revenue by layer count
- 图：2004-2008 Meadville Group Revenue by application
- 图：1990-2009年Unimicron收入统计
- 图：1995-2009Q1 Unimicron利润率统计

- 图 Unimicron全球排名
- 图: Unimicron组织图
- 图: Unimicron Technology Roadmap
- 图: 2009年Unimicron各类产品的营收及占比
- 图: Unimicron工厂分布
- 图: 2006年-2009年底Unimicron各类型产品产能统计
- 图: 2007-2009年Unimicron产品应用领域
- 表: COMPEQ General Capabilities 产品种类
- 表: COMPEQ HDI 产品种类
- 表: COMPEQ High Layer Count / Regular产品种类
- 表: COMPEQ Rigid-Flex产品种类
- 表: COMPEQ Flex产品种类
- 图: 2004-2008年COMPEQ收入与毛利统计
- 图: COMPEQ 全球分支机构及分布
- 图: 2004-2008年COMPEQ产品应用领域及占比
- 表: 2007-2008年COMPEQ产值及产量统计
- 表: 2007-2008年COMPEQ销量及销售额统计
- 表: 2004-2009年1季度 COMPEQ研发投入资金统计 (单位: 新台币千元)
- 表: COMPEQ Employees in Taiwan
- 表: Unitech 手机技术发展路线图 (Unit : um)
- 表: Unitech Rigid-Flex技术发展路线图 (Unit : um)
- 图: 2007-2009年Unitech收入与净利润统计
- 图: 2008-2010年Unitech营业收入月度走势图 (单位: 新台币百万元)
- 图: 2008年Unitech不同产品营收及占比 (by layer count)



- 图：2006-2008年Unitech各地区销售收入及占比 (by region)
- 图：WUS Capabilities of HDI
- 图：WUS Capabilities of RF Module
- 图：WUS Capabilities of Multi-Layer
- 图：2004-2009年WUS收入与毛利率统计
- 图：2005-200Q3年GCE Income Statement (unit NT\$000)
- 图：2009Q1 GCE不同产品的销售占比
- 图：GCE产品销售的区域占比
- 表：GCE设备清单
- 表：GCE生产能力
- 图：2008-2010年Chin Poon月度收入走势图
- 图：Chin Poon组织结构图
- 表：2006-2008年Chin Poon地域收入结构(单位：新台币千元)
- 表：2009年Chin Poon全球各厂产能 (by layer) (单位：K m²/M)
- 表：2007-2009年Chin Poon的PCB各应用领域的产值和占比
- 表：2007-2008年Chin Poon主要产品销量及销售额统计 (单位：新台币千元；M²)
- 图：2007-2009年Tripod Technology月度收入走势图 (单位：新台币千元)
- 表：2009 Tripod Technology产能规划统计
- 表：2009 Tripod Technology产品的应用领域及占比
- 表：2009 Tripod Technology产品的层数分类及占比
- 图：2004-2009年PLOTECH收入与毛利统计 (单位：百万新台币)
- 表：PLOTECH Production Capabilities
- 表：HDI Capability and Roadmap of HannStar Board

- 表: Multi-Layer Board Capability and Roadmap of HannStar Board
- 图: 2010Q1 of HannStar Board产品应用领域及占比
- 图: 2005-2009年Hann收入与毛利统计 (单位: 新台币千元)
- 表2009-2010 monthly net operating revenue
- 表: HannStar Board' s total capacity, 2006-2010
- 表: TPC 生产工艺类别及Standard Capability
- 图: 2008-2010 TPC营收及毛利季度走势 (单位: 百万人民币)
- 图: TPC组织结构图
- 图: 2006-2009H1 TPC产品分类及占比
- 图: 2006-2009年Kingboard 收入与毛利润统计 (单位: 百万港元)
- 图: 2009年 Kingboard 利润构成
- 图: 2008-2009 Elec & Eltek PCB 收入按地区统计 (单位: 千美元)
- 图: 2008 Elec & Eltek PCB按层数的收入结构
- 图: 2009 Elec & Eltek PCB按层数的收入结构
- 图: Dynamic组织结构
- 图: Dynamic生产基地
- 图: 2001-2009年Dynamic收入统计
- 图: 2009-2012年Dynamic总产能扩张计划
- 图: 2009-2012年Dynamic台湾厂总产能扩张计划
- 图: 2009-2012年Dynamic昆山厂总产能扩张计划
- 图: 2009-2012年Dynamic厦门厂总产能扩张计划
- 图: 2008-2009Q1年Dynamic产品应用领域及占比
- 图: Dynamic 技术研发路线图
- 图: Dynamic 生产制造能力路线图

- 图：TPT 经营网络的地区分布
- 图：TPT 主要客户
- 图：2007-2009 TPT 营业收入及增长率的月度走势图（百万新台币）
- 图：TPT 主要产品的营收比例
- 图：TPT 产品的应用领域及占比
- 图：2007-2009年 TPT 产能规划（千平方尺/月）
- 图：2005-2009年 TPT 资本支出金额与产能对比
- 图：Viasystems' PCB technology roadmap for capabilities and processes

- 表：2005-2009年Viasystems营业收入与运营利润统计
- 表：2007-2009年Viasystems收入按地区统计
- 表：2007-2009年Viasystems产品的应用领域及占比
- 表：2008-2009年Viasystems的应用领域及收入
- 表：2009年 Viasystems 主要客户及收入占比
- 图：2007-2009财年 Daisho Microline营收统计（单位：百万港元）
- 表：2008-2009Q2-Q3 Daisho Microline 营业收入按地区统计（单位港币千元）

- 图：2005-2009财年IBIDEN收入统计
- 图：2006-2010财年IBIDEN 研发投入
- 图：2009财年IBIDEN收入的按地区统计
- 图：FY2008 sales by segment
- 图：2007-2009财年CMK营收统计
- 图：2008-2009 CMK 收入构成（按产品划分）
- 图：2008-2009 CMK 收入构成（按区域划分）

- 图：2008-2009 CMK 收入构成（按应用领域划分）
- 图4-89 CMK中国基地简介
- 图：2002-2008希门凯电子（无锡）有限公司销售收入（单位：千美元）
- 图：2002-2008希门凯电子（无锡）有限公司产量统计（单位：平方米）
- 图：2008希门凯电子（无锡）有限公司产品应用领域及占比
- 图：希门凯电子（无锡）有限公司的主要产品及占比 (by layer)

购买报告

价 格	电子版： 7500元	电话： 010-8260.1561/62/63
	纸质版： 7000元	传真： 010-8260.1570
页数： 153页		邮箱： hanyue@waterwood.com.cn
发布日期： 2010-06		网址： www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511106.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。